

<전 매체> 2022년 12월 30일(목) 배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.



중소벤처기업부

보도참고자료



- 문의 : 중소기업부 기술보호과 노진상 과장(044-204-7780),
추형준 사무관(7785), 조성혜 주무관(7787)

'22년 테크브리지(Tech-Bridge)활용 상용화 연구개발(R&D)

상반기 과제 참여기업 모집

- 기술거래 체제(플랫폼)을 통해 공공기술을 이전받은 중소기업의 후속 상용화 기술개발을 위한 상반기 20개 과제 신규지원
 - * '22년 상·하반기 총 40개 신규과제, 350억 원 규모 지원
 - ** 범부처통합연구지원시스템(IRIS)에서 온라인 접수 ('22.1.21 ~ 2.7)
- 대학·연구소에서 보유한 핵심기술 이전을 통한 소재·부품·장비 분야 중소기업의 기술경쟁력 강화 및 기술자립 유도 기대

중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 국내 소재·부품·장비분야 중소기업의 기술경쟁력을 제고하고 기술 기술사업화 역량제고 촉진을 위해 '22년 1월 21일(금)부터 2월 7일(월)까지 '2022년 상반기 테크브리지(Tech-Bridge) 활용 상용화기술개발 사업' 20개 과제 참여기업을 모집한다고 밝혔다.

'테크브리지(Tech-Bridge) 활용 상용화기술개발 사업'은 독자적인 기술개발이 어려운 중소기업이 대학·연구기관이 보유한 핵심기술을 활용해 사업화 성과를 제고할 수 있도록 지원하는 대표적인 상용화 연구개발(R&D) 사업으로 '22년 예산은 350억 원이다.

* 테크브리지(Tech-Bridge) 활용 상용화기술개발(R&D) 지원사업: 총 사업비 2525억 원('20년 ~ '27년)

지원분야와 유형은 지정공모 형태로 기술수요조사와 산·학·연 전문가 검토를 통해 확정된 204개 공모과제(RFP, Request For Proposal)내에서 현장수요에

맞춰 자유롭게 응모가 가능하다.

또한, 기술보증기금에서 운용 중인 “지식재산(IP)인수 보증” 및 “사업화 보증”과 연계해 “기술이전-후속 상용화연구개발(R&D)-양산자금”으로 이어지는 원스톱(One-Stop)패키지 지원으로 중소기업의 기술이전 비용 부담을 완화하고 사업화 성공률을 높일 예정이다.

* (지식재산(IP) 인수 보증) 지식재산(IP) 인수 추진 기업에게 지식재산(IP)인수를 위한 자금착수금 기술료 등 보증

* (사업화 보증) 연구개발(R&D) 완료 후 제품양산에 소요되는 운전, 시설자금 보증

중소기업의 상용화 기술개발 과정에는 이전기술 노하우를 전수하고 기술 개발을 신속하게 추진할 수 있도록 기술을 이전한 대학·연구소가 반드시 참여해야 한다.

'22년에는 소·부·장 분야 상용화기술개발 40개 과제를 상·하반기에 나눠 신규 선정해 총 95.75억원을 지원할 예정이다.

< '22년 테크브리지(Tech-Bridge)활용 상용화 기술개발(R&D)사업 지원 개요 >

내역사업명	예산 (억원)	신규과제		지원규모	사업 내용
		분기	과제수(개)		
수요기반 기술이전	350	상반기	20	최대 2년, 8억원	테크브리지(Tech-Bridge)체제(플랫폼)을 활용하여 소재부품장비 분야의 중소기업 공공기술 이전 활성화 촉진 및 기술개발 지원
		하반기	20		

아울러, '22년에는 정책수요자 관점에서 그 간 사업추진 시 중소기업에서 어려움을 겪었던 부분을 최대한 개선했다.

- ① 코로나19에 따른 기업의 부담경감을 위해 '21년에 이어 '22년에도 민간부담금 비중(20%)과 현금부담 비중(10%)을 완화하고, 기술료 납부도 최대 2년간 연장한다.
- ② 대면평가 절차를 일원화하여 장시간 평가에 대한 기업의 피로도 및 부담을 완화했다.

사업신청은 '22년 1월 21일(금)부터 2월 7일(월)까지 신청 가능하며 자세한 내용은 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr)를 통해 확인할 수 있다.



이 보도 자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부
기술개발과 추형준 사무관(☎ 044-204-7785)에게 연락주시기 바랍니다.

□ **사업목적** : 소재·부품·장비 분야 중소기업의 공공기술이전 활성화 촉진 및 R&D 지원을 통한 기술·사업화 역량 제고

□ **지원규모** : 350억원('22년, 신규과제 40개, 계속과제 90개)

□ **지원대상**

○ **(주관기관)** 소재·부품·장비분야 공공기술을 이전*받아 후속 상용화 기술개발을 하고자하는 중소기업

* 과제신청접수 마감일 기준, 1년 이내 기술이전 계약을 체결한 기술(4개월 이내 계약체결 예정 포함)

○ **(공동개발기관)** 주관기관에 기술을 이전하는 대학·연구기관 등

* 기술이전기관(공공기술 보유한 대학, 출연연 등) 필수 참여

□ **지원내용** : Tech-Bridge 체제(플랫폼)을 통해 소재·부품·장비 분야의 기술이전을 받은 중소기업에 이전기술의 후속 상용화 기술개발자금 지원

- “기술이전-후속 상용화 R&D-양산자금”로 이어지는 One-stop패키지 지원

□ **지원조건**

구 분	개발기간 및 지원한도*	정부출연금 비중	지원방식
수요기반 기술이전	최대 2년, 8억원 (연 4억원)	75% 이내	지정공모

* 코로나19 특별지침에 따라 정부출연금 비중 변경 가능

참고 2 기술보증기금 Tech-Bridge 체제(플랫폼) 개요

□ 개요 및 특징

- 중소기업 개방형 혁신 등을 목적으로 연구소 등이 보유중인 공급 기술과 중소기업의 수요기술을 연결하는 기술이전 체제(플랫폼)
- 대학 및 연구소가 보유한 공급기술 외, 기보 전국 영업망을 통해 중소기업의 기술수요DB를 보유한 국내 유일의 체제(플랫폼)

□ 주요기능

- 공급기술 약 40만건 확보, 매년 1,500건 이상의 중소기업 수요기술을 발굴하여 기업, 연구기관, 기술거래기관 등 시장 참여자에게 제공
- 통계분석 모듈을 기반으로 기업의 기술수요와 공공연 기술을 자동 매칭 및 기술을 추천하는 KTMS(Kibo Technology Matching System) 탑재

* 기술정보는 기보 내부DB, 공공연 특허DB를 통해 일배치로 업데이트

【 Tech-Bridge의 정보연계 및 기능개요 】



* '15.10월 KTMS(KIBO Technology Matching System) 특허 등록

- 참여기관과 온라인에서 정보교환과 협의가 가능한 대화형 화면 제공